

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2006 年 7 月 6 日 (06.07.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/070658 A1

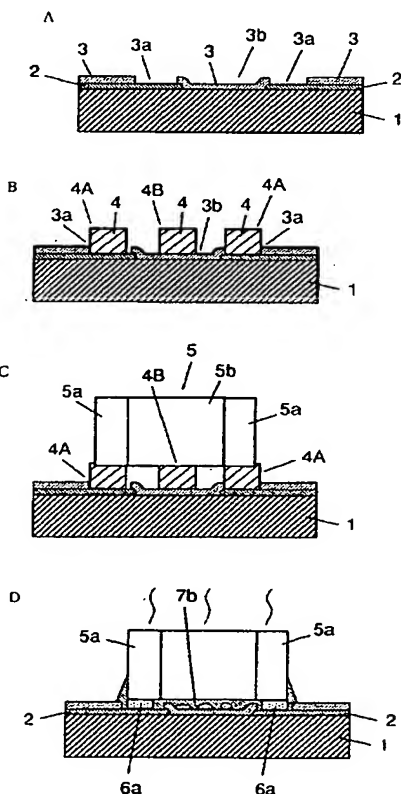
- (51) 国際特許分類:
H05K 3/34 (2006.01) H05K 1/18 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/023465
- (22) 国際出願日: 2005 年 12 月 21 日 (21.12.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2004-376071
2004 年 12 月 27 日 (27.12.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1006 番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 和田 義之 (WADA, Yoshiyuki). 境 忠彦 (SAKAI, Tadahiko).

- (74) 代理人: 岩橋 文雄, 外 (IWAHASHI, Fumio et al.); 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1006 番地 松下電器産業株式会社内 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

[続葉有]

(54) Title: ELECTRONIC COMPONENT MOUNTING METHOD AND ELECTRONIC COMPONENT MOUNTING STRUCTURE

(54) 発明の名称: 電子部品実装方法および電子部品実装構造



(57) Abstract: In electronic component mounting, an electronic component (5) is mounted by bonding a connecting terminal (5a) of the electronic component on an electrode (2) of a substrate (1) with a solder paste (4) wherein solder particles are mixed in a thermosetting adhesive. The solder paste (4) is supplied to a recessed part (3b) as an adhesion reinforcing part set on the electrode (2) and other parts, and solder printing parts (4A, 4B) are formed, respectively. Then, the electronic component (5) is mounted, and in a status where the connecting terminal (5a) and a main body part (5b) of the electronic component (5) are brought into contact with the solder printing parts (4A, 4B), respectively, heat is applied by reflow. Thus, the connecting terminal (5a) and the electrode (2) are bonded by a solder bonding part (6a), and a second resin reinforcing part (7b) for adhering the main body part (5b) on the substrate (1) is formed by adhesive ingredients of the solder printing part (4B).

(57) 要約: 熱硬化型の接着剤に半田粒子を混入した半田ペースト (4) によって電子部品 (5) の接続用端子 (5a) を基板 (1) の電極 (2) に接合して実装する電子部品実装において、電極 (2) とそれ以外の部分に設定された接着補強部位としての凹部 (3b) に半田ペースト (4) を供給してそれぞれ半田印刷部 (4A, 4B) を形成しておき、電子部品 (5) を搭載して接続用端子 (5a) と電子部品 (5) の本体部 (5b) をそれぞれ半田印刷部 (4A, 4B) に接触させた状態でリフローにより加熱する。これにより、接続用端子 (5a) と電極 (2) とを半田接合部 (6a) で接合するとともに、半田印刷部 (4B) の接着剤成分によって、本体部 (5b) と基板 (1) とを固着する第2樹脂補強部 (7b) を形成する。

WO 2006/070658 A1



OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書